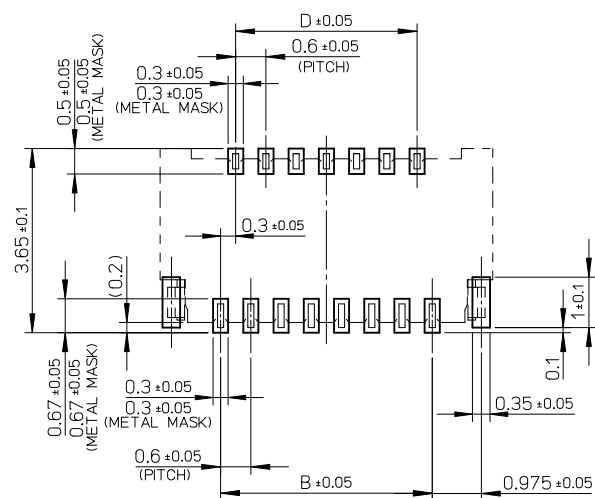
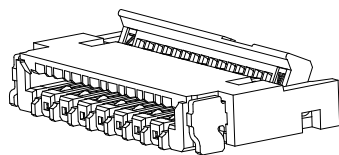
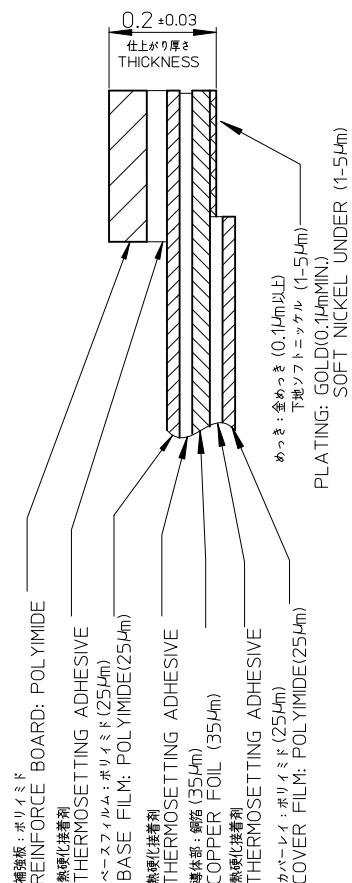




RECOMMENDED P.W.B. PATTERN LAYOUT
 推奨メタルマスク厚: $t=0.1\text{mm}$
 RECOMMENDED METAL MASK THICKNESS: $t=0.1\text{mm}$

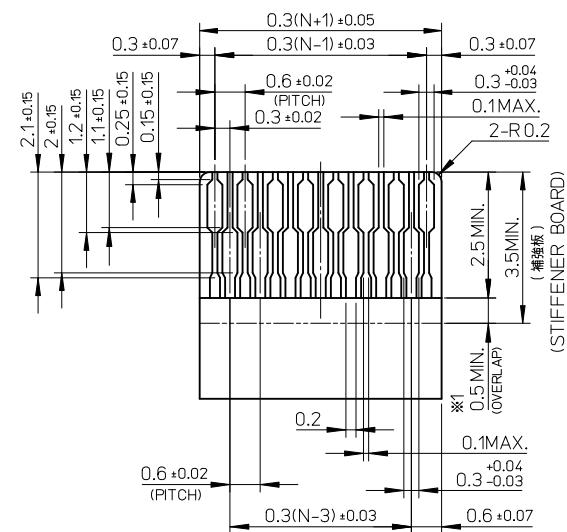


ISO VIEW (参考)



FPC構成推奨仕様

STRUCTURE OF FPC



N:極数
N:CIRCUITS

適合する金めっきFPC推奨寸法
APPLICABLE FPC OF GOLD PATING
RECOMMENDED DIMENSION

(仕上がり厚さ: 0.2 ± 0.03)
(THICKNESS: 0.2 ± 0.03)

FPCについて:

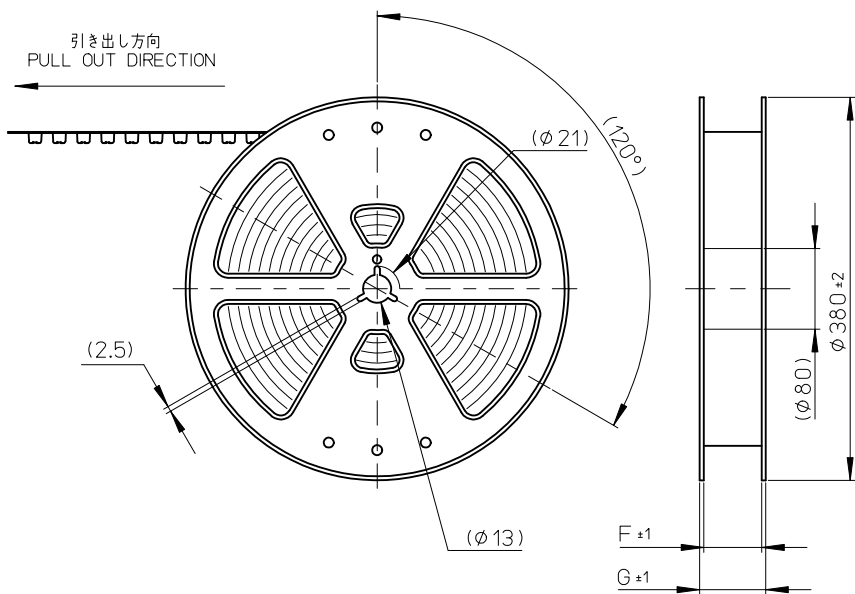
抜き方向は、導体側から補強板側を推奨致します。
 補強フィルム材質は、ポリイミドを推奨致します。
 接着剤は熱硬化接着剤を推奨致します。
 尚、接着剤の接点部への付着は導通不良の原因になりますので、
 染み出しが無い様、お願い致します。

ABOUT FPC:

RECOMMENDED PUNCHER DIRECTION:
FROM CONDUCTOR SIDE TO STIFFNER FILM SIDE.
RECOMMENDED MATERIAL:
STIFFENER FILM : POLYIMIDE
BONDING AGENT : THERMOSETTING AGENT
PLEASE PUT APPROPRIATE AMOUNT OF ADHESIVE
ADHERING BECAUSE THERE IS A POSSIBILITY THAT
THE EXTRA ADHESIVE CAUSES THE DEFECT IN
ELECTRICAL CONTINUITY.

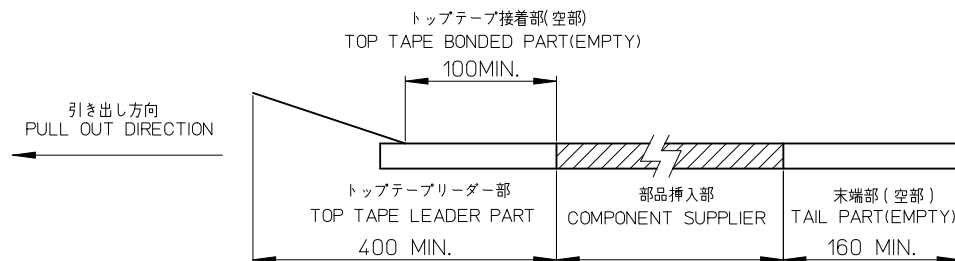
※1 補強板の長さが図面通りに確保できない場合は、カバーレイと補強板のオーバーラップ寸法を0.5mm以上としてください。
WHEN STIFFENER BOARD DIMENSION CAN NOT SECURE AS DRAWING, PLEASE GIVE THE OVERLAP SIZE OF COVER FILM AND STIFFENER BOARD AS 0.5mm MINIMUM.

REVISED EC NO: J2012-0121 DRAWN:YUASEGAWA 2011/07/25 CHKD:K TAKAHASHI 2011/07/25 APPR:KMORI KAWA 2011/07/28	DESCRIPTION	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE ++	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION		
		10 UNDER	± 0.2	DRAWN BY HONO	DATE 2009/07/21	TITLE 0.3 FPC CONN. BACK FLIP HOUSING ASSY				
		10 OVER 30 UNDER	± 0.25	CHECKED BY HSHIMOYAMA	DATE 2009/07/21					
		30 OVER	± 0.3	APPROVED BY KMORI KAWA	DATE 2009/07/21	MOLEX MOLEX INCORPORATED DOCUMENT NO. SD-502598-001 SHEET NO. 2 OF 2				
		ANGULAR ±1 °		MATERIAL NO. SEE TABLE						
	REV	DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SIZE A3	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION					



注記)
NOTES

- 製品番号502598-***11の詳細寸法は、製品単体図面を参照下さい。
IN THE PACKAGE PART NUMBER 502598-***11 DETAIL DIMENSIONS,
SEE SALES DRAWING FOR CONNECTOR.
- 梱包数量: 3000個/リール
NUMBER OF CONNECTORS : 3000 PCS/REEL
- リードテープ長さ
LEAD TAPE LENGTH



- カバートープの剥離強度については、IEC60286-3に準拠
COVER TAPE PEEL FORCE IS DEFINED BY IEC 60286-3.
- 材料
MATERIAL
キャリアテープ: ポリスチレン (PS)
CARRIER TAPE: POLYSTYRENE (PS)
トップテープ: ポリエチレンテレフタレート (PET)、他
TOP TAPE: POLYETHYLENE TEREPHTHALATE (PET), OTHERS
リール: ポリスチレン (PS)
REEL: POLYSTYRENE (PS)
- ELV 及び RoHS 適合品
ELV AND RoHS COMPLIANT

REVISED EC NO: J2011-0028 DRWN: HONO01 CHKD: HSHIMOYAMA APPR: KMORIKAWA	DESCRIPTION	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE ---	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION		
		10 UNDER	± ---	DRAWN BY HONO	DATE 2009/07/21	TITLE 0.3 FPC CONN. BACK FLIP TAPING PACKAGE (502598-**11 SERIES)				
		10 OVER 30 UNDER	± ---	CHECKED BY HSHIMOYAMA	DATE 2009/07/21					
		30 OVER	± ---	APPROVED BY KMORIKAWA	DATE 2009/07/21	MOLEX INCORPORATED				
		ANGULAR ±1 °		MATERIAL NO.		DOCUMENT NO.		SHEET NO.		
	DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SEE TABLE		SD-502598-002		1 OF 2			
	B	REV	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION							

F

E

D

C

B

A

F

E

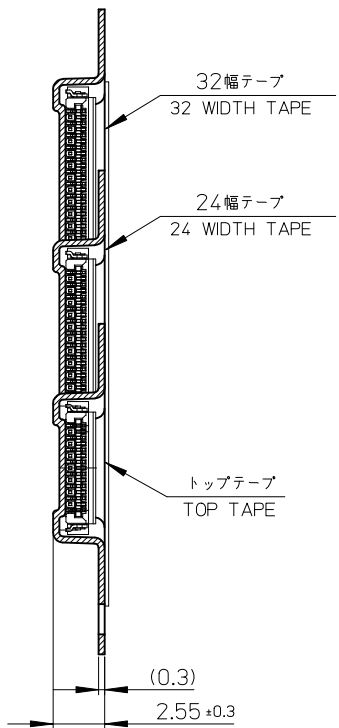
D

C

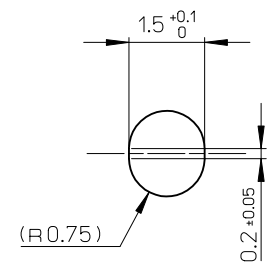
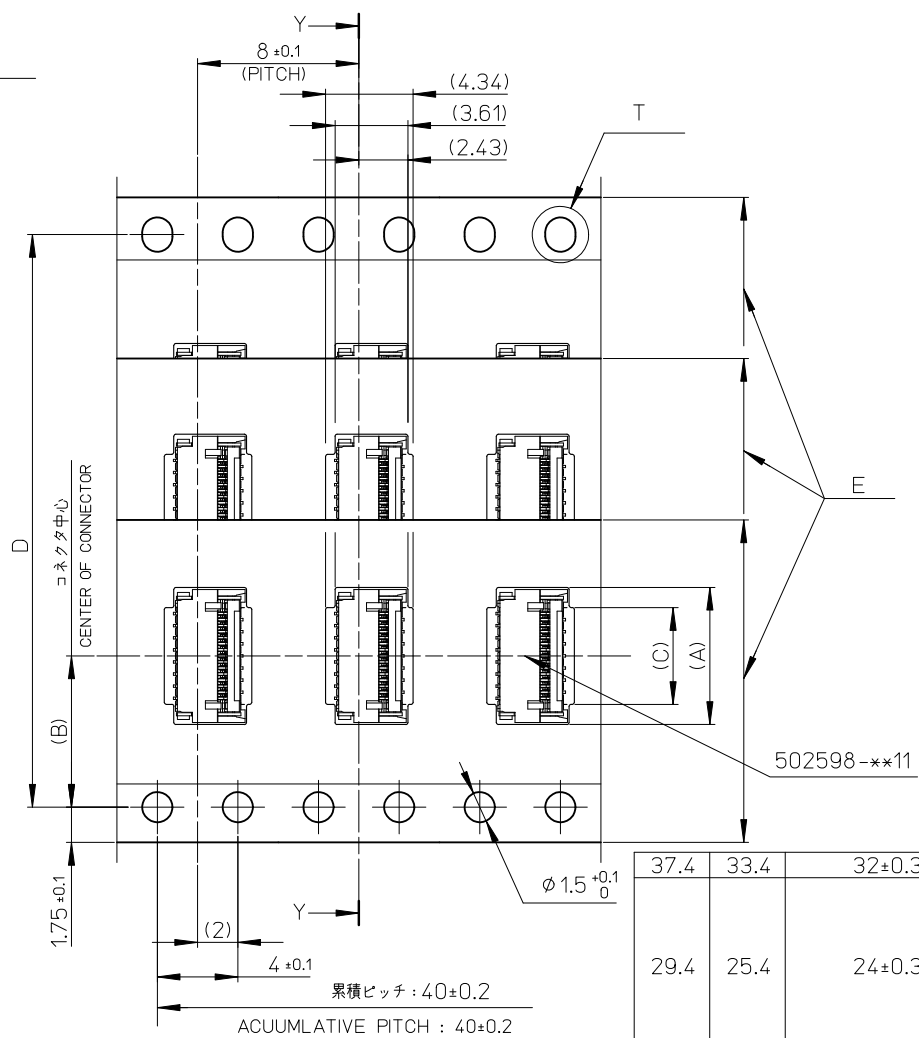
B

A

引き出し方向
PULL OUT DIRECTION



断面 Y-Y
SECTION Y-Y



T 部詳細
DETAIL T

37.4	33.4	32±0.3	28.4	15.7	14.2	17.6	502598-5191	51
29.4	25.4	24±0.3		13.9	11.5	15.8	502598-4591	45
				12.1		14	502598-3991	39
				10.3		12.2	502598-3391	33
				9.1		11	502598-2991	29
				8.5		10.4	502598-2791	27
				7.9		9.8	502598-2591	25
				7.3		9.2	502598-2391	23
G	F	E キャリアテープ幅 EMBOSSED TAPE WIDTH	D	C	B	A	製品番号 MATERIAL NO.	極数 CIRCUITS

REVISED
EC NO: J2011-0028
2010/07/06
DRWN:HON001
CHKD:SHIMOYAMA
2009/07/21
APPR:KMORIKAWA
2010/07/08

DESCRIPTION
REV

GENERAL TOLERANCES
(UNLESS SPECIFIED)

10 UNDER ± ---
10 OVER 30 UNDER ± ---
30 OVER ± ---
ANGULAR ±1 °
DRAFT WHERE APPLICABLE
MUST REMAIN
WITHIN DIMENSIONS

DIMENSION STYLE
MM ONLY

DRAWN BY HONO
DATE 2009/07/21
CHECKED BY SHIMOYAMA
DATE 2009/07/21
APPROVED BY KMORIKAWA
DATE 2009/07/21
MATERIAL NO.

SEE TABLE

SCALE

DESIGN UNITS
METRIC

THIRD ANGLE
PROJECTION

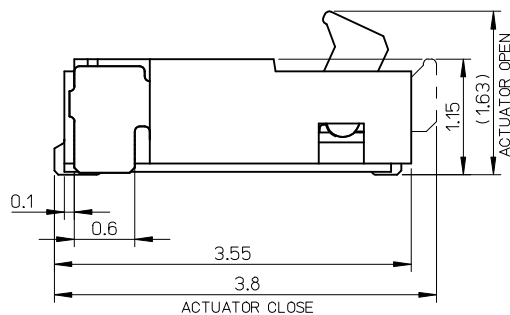
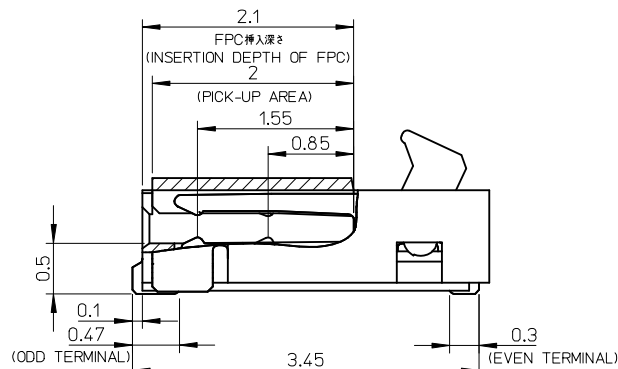
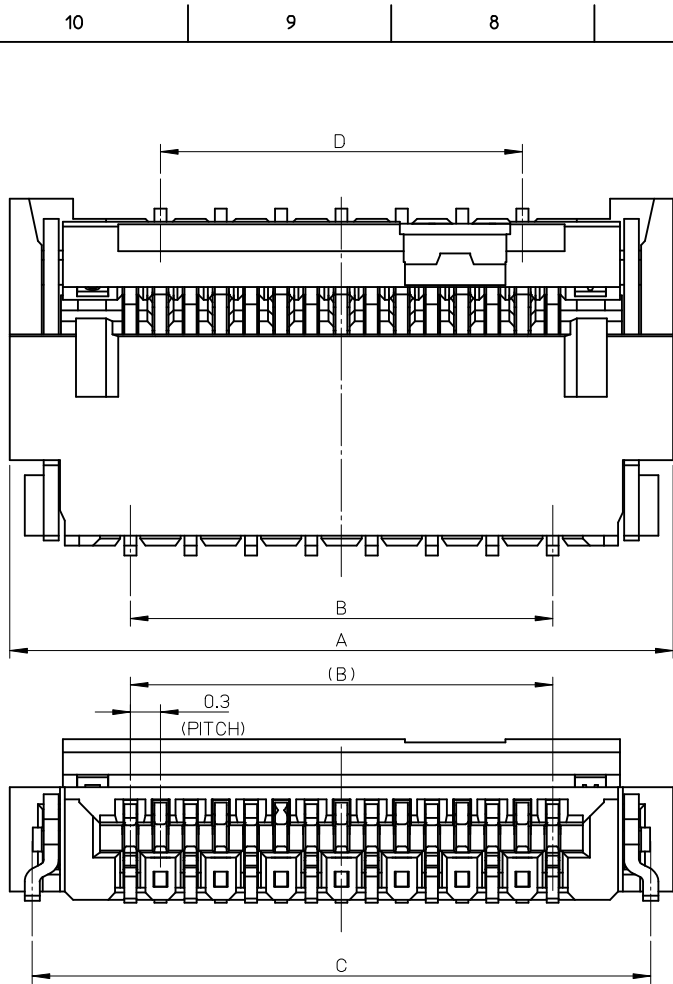
TITLE
0.3 FPC CONN. BACK FLIP
TAPING PACKAGE
(502598-**11 SERIES)

MOLEX INCORPORATED

DOCUMENT NO.
SD-502598-002

SHEET NO.
2 OF 2

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX
INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION



注記 NOTES:

1.材質 MATERIAL

ハウジング: LCP(液晶ポリマー)、白色、ガラス充填、UL94V-0
HOUSING: LIQUID CRYSTAL POLYMER, WHITE (NATURAL)
GLASS FILLED, UL94V-0
アクチュエータ: ポリアミド樹脂
黑色、ガラス充填、UL94HB

ACTUATOR: POLYAMIDE
BLACK GLASS FILLED, UL94HB

ターミナル: 焼青銅 (t=0.12)
TERMINAL: PHOSPHOR BRONZE (t=0.12)

金具: 焼青銅 (t=0.15)
NAIL: PHOSPHOR BRONZE (t=0.15)

2.めっき仕様 PLATING

ターミナル TERMINAL

接点部: 金めっき 0.1μm以上
CONTACT AREA: GOLD 0.1 MICROMETER MINIMUM

半田付け部: 金めっき
SOLDER TAIL AREA: GOLD

下地めっき: ニッケル 1.0μm以上
UNDER PLATING: NICKEL 1.0 MICROMETER MINIMUM

金具 NAIL
錫めっき 1.0μm以上
TIN PLATING 1.0 MICROMETER MINIMUM

下地めっき: ニッケル 1.0μm以上
UNDER PLATING: NICKEL 1.0 MICROMETER MINIMUM

3.平坦度は、0.1ミリ以下とする。
TAILS COPLANARITY TO BE 0.1 MAXIMUM.

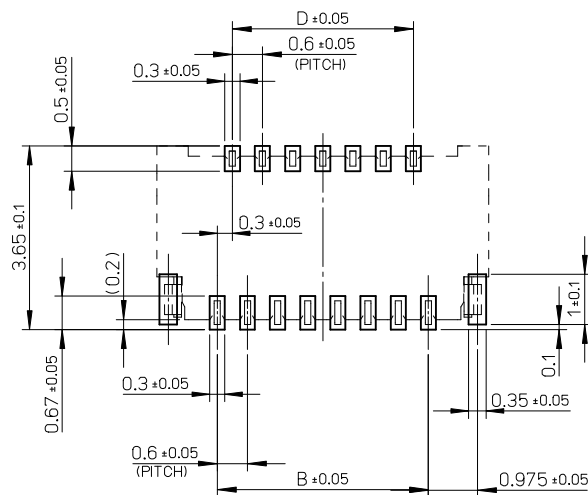
4.ELV及びRoHS適合品
ELV AND RoHS COMPLIANT

5.本製品は502598-**-91の端子材料変更品である。
THIS PRODUCT IS CHANGE OF TERMINAL MATERIAL
FOR 502598-**-91.

0.125	14.4	16.95	15	17.4	502598-5193	51
0.112	12.6	15.15	13.2	15.6	502598-4593	45
0.105	11.4	13.95	12.0	14.4	502598-4193	41
0.098	10.8	13.35	11.4	13.8	502598-3993	39
0.085	9	11.55	9.6	12	502598-3393	33
0.077	7.8	10.35	8.4	10.8	502598-2993	29
0.072	7.2	9.75	7.8	10.2	502598-2793	27
0.068	6.6	9.15	7.2	9.6	502598-2593	25
0.063	6	8.55	6.6	9	502598-2393	23
0.048	4.2	6.75	4.8	7.2	502598-1793	17
0.043	3.6	6.15	4.2	6.6	502598-1593	15
重さ (g) WEIGHT(g)	D	C	B	A	EMBOSSED PACKAGE オーダー番号 ORDER NO.	極数 CIRCUITS

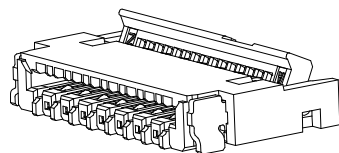
CONNECTOR SERIES NO. 502598-**-21

REVISED EC NO: J2014-0146 DRAWN:KAGUMO CHKD:K TAKAHASHI APPR:YNOGAWA	DESCRIPTION	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE ---	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION				
		10 UNDER	± 0.2	KMIYAHARA	2012/07/18	TITLE 0.3 FPC CONN. BACK FLIP HOUSING ASSY						
		10 OVER 30 UNDER	± 0.25	KTAKAHASHI	2012/07/18							
		30 OVER	± 0.3	KMORIKAWA	2012/08/01	molex						
		ANGULAR ±1 °		MATERIAL NO.						DOCUMENT NO.		SHEET NO.
		DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SEE TABLE						SD-502598-003		1 OF 2
REV	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION											

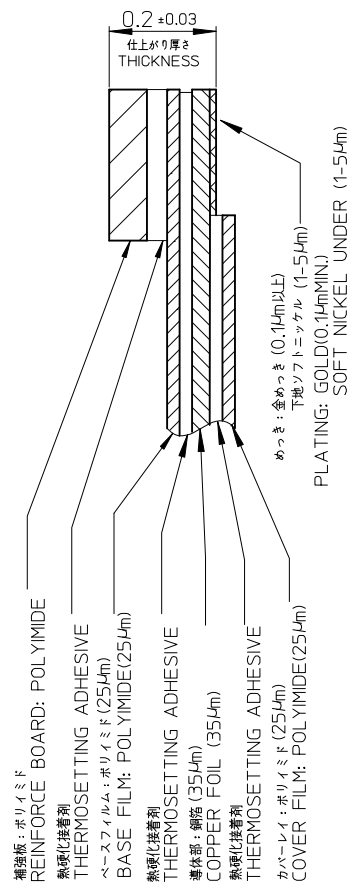


RECOMMENDED P.W.B. PATTERN LAYOUT

マスク厚: 100 μm
 マスク開口率: 100%
 SCREEN THICKNESS: 100 μm
 SCREEN OPEN RATIO: 100%

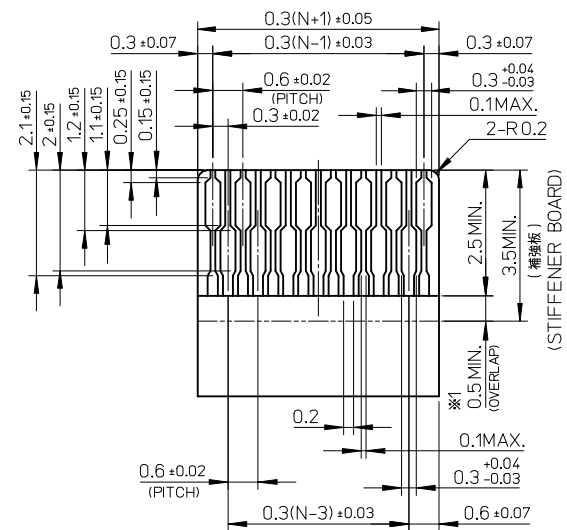


ISO VIEW (参考)



FPC構成推奨仕様

STRUCTURE OF FPC



適合する金めっきFPC推奨寸法
APPLICABLE FPC OF GOLD PATING
RECOMMENDED DIMENSION

(仕上がり厚さ: 0.2 ± 0.03)
(THICKNESS: 0.2 ± 0.03)

FPCについて:

抜き方向は、導体側から補強板側を推奨致します。

補強フィルム材質は、ポリイミドを推奨致します。

接着剤は熱硬化接着剤を推奨致します。

尚、接着剤の接点部への付着は導通不良の原因になりますので、

染み出しが無い様、お願い致します。

ABOUT FPC:

RECOMMENDED PUNCHER DIRECTION:

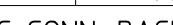
FROM CONDUCTOR SIDE TO STIFFNER FILM SIDE.

RECOMMENDED MATERIAL:

STIFFENER FILM : POLYIMIDE

BONDING AGENT : THERMOSETTING AGENT

PLEASE PUT APPROPRIATE AMOUNT OF ADHESIVE ON ADHEREND BECAUSE THERE IS A POSSIBILITY THAT THE EXTRA ADHESIVE CAUSES THE DEFECT IN ELECTRICAL CONTINUITY.

REVISED EC NO: J2014-0146 DRAWN: KAGUMO CHK'D: K TAKAHASHI APP'R: YNOGAWA	DESCRIPTION	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE ---	DESIGN UNITS METRIC	 THIRD ANGLE PROJECTION	
		10 UNDER	± 0.2	DRAWN BY KMIYAHARA	DATE 2012/07/18	TITLE 0.3 FPC CONN. BACK FLIP HOUSING ASSY			
		10 OVER 30 UNDER	± 0.25	CHECKED BY KTAKAHASHI	DATE 2012/07/18				
		30 OVER	± 0.3	APPROVED BY KMORIKAWA	DATE 2012/08/01				
		ANGULAR ±1 °		MATERIAL NO.					
REV	DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS	SEE TABLE		SD-502598-003		2 OF 2			
		THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION							



О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

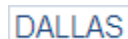
Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок





Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>